

**Inhalt**

	Seite
Vorwort .....	2
1 Anwendungsbereich .....	5
2 Normative Verweisungen .....	5
3 Begriffe .....	6
4 Allgemeines .....	7
4.1 Schutzniveau (Geräteschutzniveau (EPL)) .....	7
4.2 Zusätzliche Anforderungen für die Schutzniveaus „ma“ und „mb“ .....	7
4.3 Zusätzliche Anforderungen für das Schutzniveau „ma“ .....	7
4.4 Bemessungsspannung und zu erwartender Kurzschlussstrom .....	7
5 Anforderungen an Vergussmassen .....	7
5.1 Allgemeines .....	7
5.2 Materialangaben .....	8
5.3 Eigenschaften des Vergussmasse .....	8
6 Temperaturen .....	8
6.1 Allgemeines .....	8
6.2 Bestimmungen der begrenzenden Temperaturen .....	9
6.3 Temperaturbegrenzung .....	9
7 Baubestimmungen .....	9
7.1 Allgemeines .....	9
7.2 Fehlerermittlung .....	10
7.3 Freier Hohlraum in der Vergusskapselung .....	12
7.4 Dicke der Vergussmasse .....	14
7.5 Schaltkontakte .....	18
7.6 Äußere Anschlüsse .....	18
7.7 Schutz von blanken, spannungsführenden Teilen .....	18
7.8 Zellen und Batterien .....	19
7.9 Schutzeinrichtungen .....	21
8 Typprüfungen .....	23
8.1 Prüfungen an der Vergussmasse .....	23
8.2 Prüfungen an den Betriebsmitteln .....	24
9 Stückprüfungen .....	28
9.1 Sichtprüfungen .....	28
9.2 Durchschlagfestigkeitsprüfung .....	28
10 Kennzeichnung .....	29
Anhang A (informativ) Grundsätzliche Anforderungen an Vergussmassen für „m“-Geräte .....	30
Anhang B (informativ) Prüfmusterzuordnung .....	31
Literaturhinweise .....	32

Anhang ZA (normativ) Normative Verweisungen auf internationale Publikationen mit ihren entsprechenden europäischen Publikationen .....	34
Anhang ZZ (informativ) Zusammenhang mit Grundlegenden Anforderungen von EU-Richtlinien .....	36
<b>Bilder</b>	
Bild 1 – Abstände durch die Vergussmasse .....	15
Bild 2 – Mindestabstände für Multilayer-Leiterplatten.....	17
Bild 3 – Anordnung von Sperrdioden.....	20
Bild A.1 – Grundsätzlichen Anforderungen an Vergussmassen für „m“-Geräte .....	30
<b>Tabellen</b>	
Tabelle 1 – Abstände durch die Vergussmasse .....	12
Tabelle 2 – Mindestdicke der Vergussmasse um freie Hohlräume für „m“-Geräte der Gruppe III.....	13
Tabelle 3 – Mindestdicke der Vergussmasse um freie Hohlräume für „m“-Geräte der Gruppe I und der Gruppe II .....	14
Tabelle 4 – Dicke der Vergussmasse .....	16
Tabelle 5 – Mindestabstände bei Multilayer-Leiterplatten .....	17
Tabelle 6 – Prüfdruck.....	27
Tabelle B.1 – Prüfmusterzuordnung .....	31